LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI08_1+6+1_1,60_17.5

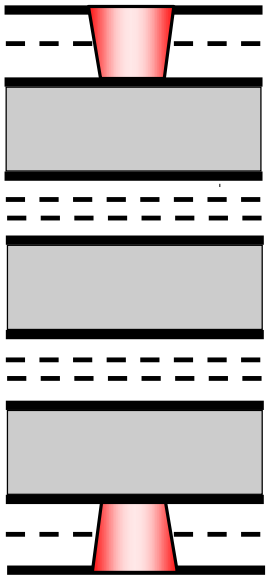
8 - Lagen

Kerne: 0,36 mm Cu 17/17 µm

WE-Artikel Nr.: | **1 + 6 + 1**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	66	
	2			17,5 µm		16	
			0,360 mm			360	
	3			17,5 µm		16	
					2 x 1080	134	
	4			17,5 µm		16	
			0,360 mm			360	
	5			17,5 µm		16	
					2 x 1080	134	
	6			17,5 µm		16	
			0,360 mm			360	
	7			17,5 µm		16	
					1 x 1080	66	
	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
			Gesamtdicke Material:			1600	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,60**	+/-	0,11	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,69	+/-	0,14	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,75	+/-	0,16	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	Seite:	5+